****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader Enquiries:** | **Press Contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.es](http://www.congatec.es) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |

**

*Módulo COM Express de Congatec con SoC AMD Embedded G-Series que ofrece hasta un 30% más de rendimiento gráfico*

*Texto y foto también disponible online en::* [*http://www.congatec.com/press*](http://www.congatec.com/press)

Nota de prensa

**congatec lanza el módulo COM Express   
con el nuevo SoC AMD G-Series**

El nuevo módulo conga-TR3 basado en SoC AMD G-Series ofrece hasta un 30% más de rendimiento gráfico y RAM DDR4 más rápida

**Deggendorf, Alemania, de 2016 \* \* \*** congatec, una empresa líder en tecnología de módulos informáticos integrados, ordenadores monoplaca (SBC), servicios de fabricación y diseño embebidos (EDM), ha ampliado su cartera de módulos COM Express con el lanzamiento del nuevo SoC AMD G-Series (llamado de Brown Falcon). En comparación con los módulos basados en la anterior generación de SoCs de AMD Embedded G-Series, el nuevo SOC conga-TR3 con procesador de doble núcleo AMD GX-217GI ofrece hasta un 30% más de rendimiento gráfico y un 15% más de rendimiento del sistema en general. Además, el SoC AMD G-Series soporta memoria DDR4 más rápida y más eficiente, PCI Express Gen 3.0 para las extensiones específicas del cliente, así como aceleración gráfica DirectX 12 muy potente. Esto posiciona al nuevo módulo como la primera opción para muchas aplicaciones embebidas de gran demanda. Con un TDP máximo configurable de 12-15 vatios, también es ideal para diseños sin ventilación forzada.

Dado que estos nuevos procesadores AMD G-Series son compatibles en pin con los SoC AMD Embedded R-Series (llamados Merlin Falcon) y se basan en la misma microarquitectura del procesador, los fabricantes de equipos se benefician de una muy alta escalabilidad que les permite implementar de forma rápida y eficiente soluciones desde un nivel básico al avanzado, con un solo diseño de módulo. En el segmento de rendimiento intensivo de gráficos, el nuevo módulo conga-TR3 ofrece el punto de precio óptimo para aplicaciones de gran volumen.

El espectro de aplicaciones abarca desde aplicaciones de juegos con gráficos intensos y aplicaciones de señalización digital con dos pantallas 4K, imagen y análisis de vídeo en sistemas de visión industrial, y en tecnología de visualización sanitaria, y comercio al por menor, puntos de venta y automatización. Otros casos de uso incluyen aplicaciones intensivas de cálculo, como la computación perceptiva, cortafuegos de red con inspección profunda de paquetes (DPI) y análisis de grandes volúmenes de datos. Gracias al soporte HSA 1.0 tales cargas de trabajo se pueden distribuir a la CPU y a los núcleos gráficos altamente paralelos, ofreciendo un entorno muy eficiente de consumo de energía.

Detalles técnicos

El nuevo módulo conga-TR3 COM Express Basic con 6 pines está equipado con el procesador de doble núcleo AMD Embedded G-Series SoC GX-217GI, desde 1,7 GHz a 2,0 GHz, y soporte de hasta 32 GB de memoria DDR4, opcionalmente con ECC. La nueva arquitectura AMD Graphics Core Next (GCN) Generation 3 controla hasta dos pantallas independientes de alta definición 4K Ultra @ 60Hz a través de DisplayPort 1.2 y HDMI 2.0. También tiene soporte OpenGL 4.0 y DirectX 12 para gráficos en 3D más rápidos basados en Windows 10. Los aceleradores de hardware integrados permiten el streaming de video HEVC de alta eficiencia energética en ambas direcciones.

Gracias al soporte HSA 1.0 y OpenCL 2.0, las cargas de trabajo se asignan directamente a una unidad de tratamiento más eficaz. En aplicaciones críticas para la seguridad, el procesador AMD Secure integrado proporciona cifrado y descifrado de RSA, SHA y AES acelerado por hardware.

El nuevo módulo es compatible con COM Express de 6 pines con 1x4 PCIe 3.0, 1x PEG, Gigabit Ethernet, 4 puertos USB 3.0 / 2.0, 4x USB 2.0, SPI, I²C y LPC, SDIO y 2x UART. La compatibilidad del sistema operativo se ofrece para Linux y Microsoft Windows 10, Windows 8.1 y, opcionalmente, Windows 7. También se ofrecen los servicios de diseño y fabricación embebida para placas portadoras personalizadas, así como una amplia gama de accesorios para facilitar el diseño.

La hoja de datos y más información sobre el nuevo módulo conga-TR3 están disponibles en: <http://www.congatec.com/en/products/com-express-typ6/conga-tr3.html>

**Acerca de congatec AG**congatec AG, con sede central en Deggendorf (Alemania), es un proveedor líder de módulos informáticos industriales basados en los factores de forma estándar Qseven, COM Express, XTX y ETX, así como de ordenadores de placa única y servicios EDM. Los productos de esta empresa ofrecen múltiples aplicaciones y se utilizan, por ejemplo, en las áreas de automatización industrial, tecnología médica, suministros para el sector del automóvil, aeronáutica y transporte. Los conocimientos básicos y técnicos incluyen funcionalidades BIOS extendidas de características únicas, junto con amplios paquetes de soporte de placa y controladores. A partir de la fase de diseño, los clientes reciben un apoyo adecuado a través de una gestión integral del ciclo de vida del producto. Los productos son fabricados por proveedores especializados de acuerdo con las más modernas normas de calidad. En la actualidad congatec cuenta con 177 empleados y con establecimientos situados en Taiwán, Japón, China, Estados Unidos, Australia y la República Checa. Para obtener más información, consulte en [www.congatec.com](http://www.congatec.com/h) o a través de [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec/h), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG/h) y [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE/h).

\* \* \*